

非常に柔らかく低熱抵抗、高熱伝導率でPCや通信機器内部を効率良く冷却させる熱伝導パッドです。

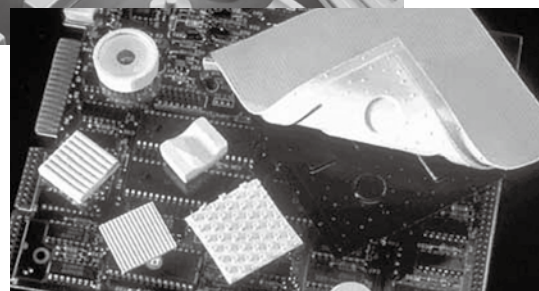
CHO-THERM・GAP FILLER

RoHS 対応品

コ・サーム ギャップファイラーは、熱に対しては高い伝導性を発揮し、電気的には絶縁性を持った、柔軟性に富む熱伝導性エラストマー製品です。
発熱体とヒートシンクまたは金属キャビネットとのすき間を埋める実装部材として、蓄熱を防ぐ優れた熱伝導性能を発揮します。

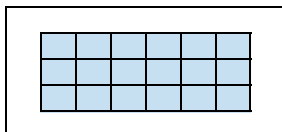
製品の特徴

- Aシリーズの特徴
 - ：形状保持のため製品の片面にアルミ箔を使用しています。
 - ：アルミ箔側に PSA が付いています。
 - ：熱拡散性能が優れています。
- Gシリーズの特徴
 - ：Gシリーズには PSA 付きはありません。
 - ：形状保持のため片面にグラスファイバーが埋め込まれています。
 - ：高さの違うギャップを埋める追従性能が優れています。

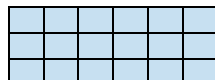


加工例

● シール抜き



● キスカット



● 抜き落とし



・ご注文の際は、材質、外形寸法、厚みを図面でご提示をお願い致します。
(例) A574 厚み T4.0 mm
大きさ 111 mm×38 mm

コ・サーム ギャップファイラーの基本的特性

型式	G974	A569	G569	A579	G579	テスト方法
フィラー	窒化ホウ素	—	—	—	—	—
色	ブルー	グレー	グレー	ピンク	ピンク	外観
厚さ (mm)	0.25			0.25	0.38	ASTM D 374
	0.5			0.5	0.5	
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	1.5					
		1.8	1.8	1.8	1.8	
		2.5	2.5	2.5	2.5	
比重		3.3	3.3	3.3	3.3	ASTM D 792
		4.1	4.1	4.1	4.1	
		5.1	5.1	5.1	5.1	
硬度 (Shore00)	—	10	—	30	—	ASTM D 2240
硬度 (ShoreA)	40	—	—	<5	—	ASTM D 2240
たわみ率 (%)	厚さ 1.8mm	厚さ 3.3mm	—	厚さ 3.3mm	—	ASTM C 165MOD (直径 12.7mm 速度 0.64mm/分)
③34kPa (5psi)	7	20	—	22	—	
③69kPa (10psi)	11	30	—	33	—	
③172kPa (25psi)	12	50	—	55	—	
③345kPa (50psi)	13	65	—	88	—	
熱インピーダンス (°C・cm²/W)	[G] 厚さ 1mm @50psi 5.2	[G] 厚さ 1mm @10psi 9.1	—	[G] 厚さ 1mm @10psi 4.5	—	ASTM D 5470
熱伝導率 (W・m・K)	[G] 厚さ 1mm @50psi 3	1.5	—	3	—	ASTM D 5470
作動温度範囲 (°C)	−65 ~ 150	−55 ~ 200	—	−55 ~ 200	—	—
熱容量 (J/g・K)	0.9	1	—	1	—	ASTM E 1269
熱膨張係数 (ppm/K)	100	250	—	150	—	ASTM E 831
絶縁強度 kVac/mm (Vac/mil)	5.1 (200)	8 (200)	—	8 (200)	—	ASTM D 149
体積抵抗 (Ω・cm)	10 ¹⁴	10 ¹⁴	—	10 ¹⁴	—	ASTM D 257
誘電率 @1000KHz	3.2	6.5	—	8.0	—	ASTM D 150
散逸率 @1000KHz	<0.001	0.013	—	0.010	—	Chomerics
難燃性 (厚さ)	V-0 (>0.25mm)	V-0 (>0.50mm)	—	V-0 (>0.25mm)	—	UL94
アウトガス %TML (%CVM)	0.83 (0.26)	0.42 (0.08)	—	0.19 (0.06)	—	ASTM E 595

※ TBC が併記されている数値は、メーカーから仮数値として公表されている値であり、予告無く変更の可能性が御座います。